



最适合 “行动电话” BGA 返修系统

MARTIN®
Rework + Dispense Technic

BGA Engine MaFi-710

The most powerful BGA rework system

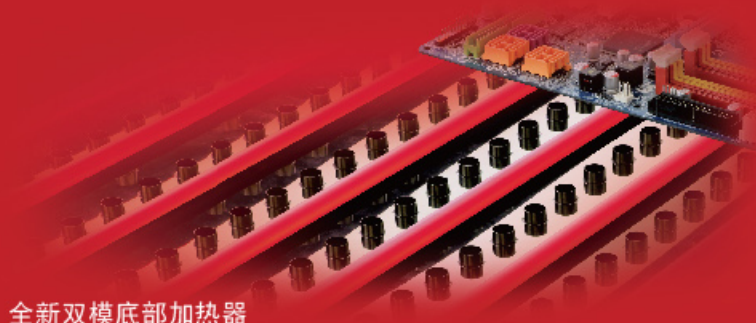
- ... Desoldering a BGA or CSP
- ... Removing old solder and residue
- ... Reballing a BGA or CSP
- ... Positioning and Placing a BGA or CSP
- ... BGA Soldering



MaFi-710 完美的完成BGA返修之任务，任意类型不同尺寸大小的BGA / Flip chip或是QFN元件都能在极简易且安全的操作下完成拆 / 回焊搭载全新双模底部加热器後的 MaFi-710 不仅能轻易的达成BGA拆焊 / 回焊同时也能轻松的完成除锡 / 植球等全方位返修工作的目标

- 独一无二的视觉对位系统，配合自动化置放系统造就了市场上精度最高的返修工作站系统

配合功能强大的双模底部加热器与高精度热风系统，使用专属的真空除锡笔更可丝毫不伤Pads的将残留锡清除一空



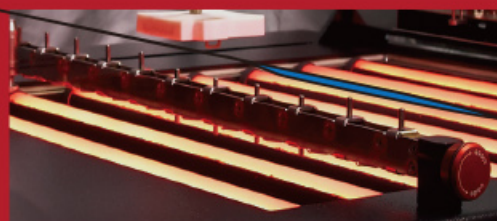
全新双模底部加热器



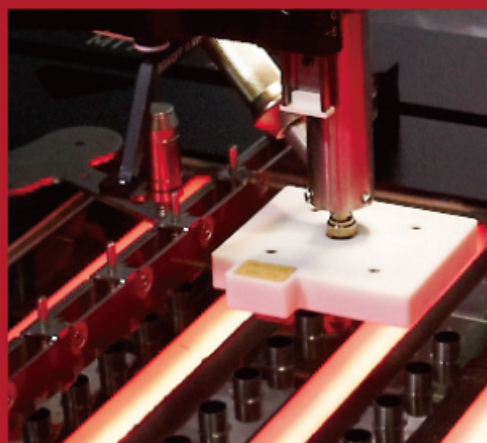
借由简单的点击几个功能按钮强大的视觉对位系统即可自动的对BGA零件位置与角度做精确计算，并借由步进马达系统将该元器件准确的自动置放于正确位置上。

BGA Engine MaFi-710

The most powerful BGA rework system



独特的**底部支撑架**，能够完美的记忆PCB底部高低起伏之高度差，如同记忆枕般提供PCB完美的支撑



功能强大的全新**双模底部加热器**，快速及时且非常均匀的提供底部预热能量，PCB受热就像在回焊炉一般，保持最低PCB板弯扭曲量

Specification

Power Input	230V / 50Hz 25A
Pressure Input	5.5~8 Bar
Hot air power output	10~250W / 40V
Hot air volume	2.0~35l / min
Hot air temp	150~400°C± 1%
Underheater power	10~110W
Underheater size	65 x 80mm
PCB size	70 x 100mm
CCD camera resolution	1944 x 2595 pixel
Auto placement stroke	X-Y-Z / 75-75-40mm
Auto placement angle	±10 °
CCD lighting	Ring type LED
PCB clipping	smart clip
PCB supporting	Flex Fix pin bar supporter (optional)
Weight	approx. 70Kg
Communication Link	USB
Program software	Easy Solder
Thermo sensors	2 + 4
Hot air nozzle	CSP 4 pieces (covering all specs) optional
(all nozzles are optional)	BGA15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 23 / 25 / 27 / 29 / 31 / 32 / 33 / 35 / 37.5 / 40 / 40.5 / 45 / 46mm...
	Socket 478B / 775 / 1207 / 1165 / 1366 / 1567

UTILITY 友达利贸易(深圳)有限公司
Utility Trading (Shenzhen) Co., Ltd.

深圳市宝安区龙华街道和平东路金銮时代大厦5楼501室

TEL: +86 (755) 28183210~6

http: // www.utility-trading.com

E-Mail: info@utility-trading.com